

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2024-026

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度及 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 13:00-14:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）至 4 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 jhtdesign@jht-design.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，以及 2023 年年度利润分配情况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 13:00-14:30 举行 2023 年年度及 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度、2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况、2023 年年度利润分配情况与

投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间: 2024年4月30日(星期二) 下午 13:00-14:30

(二) 会议召开地点: 上证路演中心

(三) 会议召开方式: 上证路演中心视频录播和网络互动

三、 参加人员

公司董事长兼总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生和财务总监黄洁女士等(具体参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年4月30日(星期二)下午13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年4月23日(星期二)至4月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 jhtdesign@jht-design.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人: 公司证券事务部

电话: 021-52277906

邮箱: jhtdesign@jht-design.com

六、 其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日